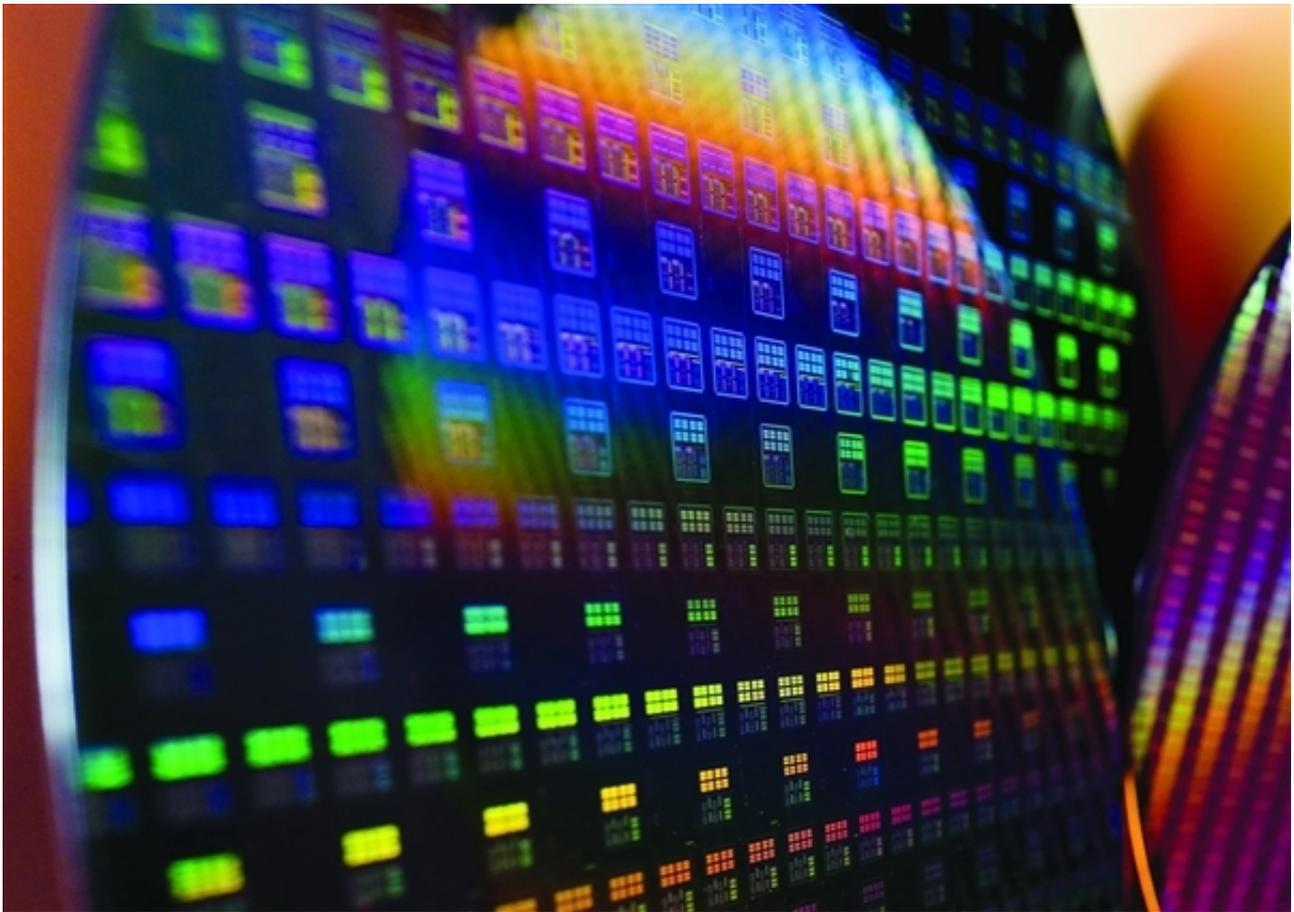


三星由于半导体行业出现急剧降温 利用率仅为70% 3nm工艺也无法挽救局势

2023年，全球半导体行业可谓状况恶劣，更加雪上加霜的是，台积电最近发布的财报表明上半年预期值不容乐观。三星作为紧随其后的第二大晶圆代工厂，也受此冲击，预计晶圆产能利用率将跌至70%甚至更低。



来自韩国媒体的报道，多家韩国晶圆代工厂面临着订单下滑、产能利用率不足的问题，包括三星、DB HiTek、Key Foundry、SK Hynix IC、Magner Chip等，其中三星的工艺比较先进，12英寸居多，利用率平均70%左右

。

后面几家厂商代工的8英寸晶圆居多，利用率也是下滑最多的，DB HiTek还有60-70%利用率，更惨的一些甚至50%的利用率都没有了。

对半导体制造来说，产能利用率不仅关系着订单多少，更严重影响了成本，光是折旧费就是一大笔费用，产线闲置太浪费了。

但是现在的需求下，三星这样的第二大晶圆代工企业都面临困境，该公司去年6月就宣布全球首发量产3nm工艺，比台积电早了半年，然而最先进工艺在手也没能救命，现在需求还稳定的反而是汽车电子等成熟工艺产品。

本文链接：<https://dqcm.net/zixun/16766324499370.html>